

RESOLUCIÓ MODIFICATIVA DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE L'ADQUISICIÓ DE DOS EQUIPAMENTS, UNA ESTACIÓ DE PUNTES I UNA MÀQUINA DE SOLDADURA

EXPEDIENT 2024/53

Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, òrgan de contractació, informa que s'han detectat un error material en la licitació del *subministrament, instal·lació i servei de redacció del projecte executiu i direcció de les obres de l'adequació d'una sala gris d'astrofísica a la Unitat Tecnològica de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona*, expedient 2024/53

- Lot 2: Estació de puntes semiautomàtica per oblees de fins a 300 mm.
- Lot 3: Equip de soldadura de xip de cara a ball (Flip-Chip Bonder) de fins 10 µm de precisió.

mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

ANTECEDENTS

En data 8 de novembre de 2024, es publica l'anunci de licitació del *subministrament, instal·lació i servei de redacció del projecte executiu i direcció de les obres de l'adequació d'una sala gris d'astrofísica a la Unitat Tecnològica de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona*, expedient 2024/53 a la PSCP.

Aquesta licitació consta de 3 lots:

- Lot 1: Redacció del projecte executiu, direcció de les obres i execució de les mateixes per a la instal·lació dels equips dels lots 2 i 3 amb requisits de control ambiental de temperatura i d'humitat
- Lot 2: Estació de puntes semiautomàtica per oblees de fins a 300 mm.
- Lot 3: Equip de soldadura de xip de cara a ball (Flip-Chip Bonder) de fins 10 µm de precisió.

El termini de presentació d'ofertes és fins el 26 de març de 2025.

En data 13 de març de 2025, la unitat promotora comunica a l'Oficina de Contractació Administrativa l'existència d'un error material en els plecs tècnics corresponents al Lot 2: *Estació de puntes semiautomàtica per oblees de fins a 300 mm* i Lot 3: *Equip de soldadura de xip de cara a ball (Flip-Chip Bonder) de fins 10 µm de precisió*.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- L'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques que disposa el següent:

Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.

D'acord amb allò que disposen els articles 73 i 181 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona,

RESOLC

Primer.- Modificar la redacció del plec de prescripcions tècniques que regeix la contractació del *subministrament, instal·lació i servei de redacció del projecte executiu i direcció de les obres de l'adequació d'una sala gris d'astrofísica a la Unitat Tecnològica de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona*, expedient 2024/53. Lot 2: *Estació de puntes semiautomàtica per oblees de fins a 300 mm* i Lot 3: *Equip de soldadura de xip de cara a ball (Flip-Chip Bonder) de fins 10 µm de precisió* en els següents termes:

Els canvis es ressalten en blau.

MODIFICACIONS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

ON DIU:

3. REQUISITS TÈCNIC

Lot 2: Taula de puntes semiautomàtica per a oblees de fins a 300 mm

Els requisits que s'enumeren a continuació han de considerar-se una línia de base mínima per a la compra, que podran ser millorats pels licitadors segons s'estableix en el plec de clàusules administratives.

- Precisió en els eixos X i Y d'almenys 5 µm.
- Desplaçament en l'eix X d'almenys 300 mm.
- Desplaçament en l'eix Y d'almenys 150 mm.
- Desplaçament en l'eix Z d'almenys 10 mm.
- Capacitat d'utilització de components d'almenys 1x1 mm com a mínim.
- Capacitat d'utilització de components d'almenys 5x5 cm com a màxim.
- Capacitat d'utilització de substrats d'almenys 15x15 cm.
- Platina d'escalfament d'almenys 400 °C i almenys 5x5 cm com a mínim.
- Capacitat d'escalfament per la cara top d'entre 1 K/s a 20 K/s
- Capacitat de soldadura per termocompressió (almenys 400 N).
- Capacitat de soldadura per termo-so.
- Capacitat de soldadura per perfil de temperatura.
- Capacitat de Pick&Place.
- Capacitat de dispensació (pasta/epoxi) amb control de flux/volum.
- Capacitat de Reballing.
- Sistema de microscòpia òptica amb camp de visió d'entre 2x2 mm i 10x10 mm amb resolució òptica d'almenys 10 µm. Visió tant per a l'alineament com per alprocés de soldadura
- Possibilitat de control extern via Ethernet i/o USB.
- Transport i instal·lació de l'instrument en les nostres instal·lacions.
- Formació d'ús de l'instrument.

HA DE DIR:

Lot 2: Taula de puntes semiautomàtica per a oblees de fins a 300 mm

Els requisits que s'enumeren a continuació han de considerar-se una línia de base mínima per a la compra, que podran ser millorats pels licitadors segons s'estableix en el plec de clàusules administratives.

- Grandària del chuck: 300 mm de diàmetre amb capacitat per a desplaçar-se almenys 300 mm x 500 mm en eixos X, Y i 30 mm en eix Z.
- Distància màxima del platen al chuck de 28 mm.
- El chuck ha de permetre una repetibilitat en el moviment d'1 µm.
- Capacitat d'utilitzar components individuals d'almenys 1x1 mm.

Finançat per

- Adaptador per a carta de puntes de 4,5 polzades.
- Capacitat de muntar almenys 10 microposicionadors en DC amb puntes dedicades així com 4 RF i 4 DC.
- Capacitat d'automatitzar el desplaçament de les puntes, en mesures a nivell d'oblia.
- Sistema antivibratori integrat.
- Microscopi amb capacitat de prendre/emmagatzemar imatges amb detecció automàtica d'objectius. Resolució mínima de 2500 x 2500 píxels i 6 MP de vídeo amb 20 fps amb una resolució òptica mínima 2 µm. Rang de moviment en l'eix Z serà d'almenys 140 mm i programable.
- Microscopi/càmera per a visualitzar el contacte al dispositiu/oblia fins i tot en cartes de puntes amb distribució de les puntes en format matricial o completament tancades, mitjançant alineament sonda-pad fora d'eix usant un microscopi addicional en la part inferior.
- Sistema de control integrat en la màquina de puntes que pugui realitzar les opcions bàsiques de control com a moviment en els diferents eixos amb un joystick, control de velocitat, sistemes de seguretat contacte-separació, càrrega i descàrrega d'oblia i les funcions d'anar al home i al centre entre d'altres.
- Possibilitat de control extern via Ethernet i/o USB.
- Transport i instal·lació de l'instrument en les nostres instal·lacions. L'equip ha de poder entrar per una porta de 1.2m de pas, per a la seva posterior posta en marxa.
- Formació de l'ús de l'instrument.

ON DIU:

Lot 3: Equip de soldadura de xip de boca a terra (Flip-Xip Bonder) d'almenys 5µm de precisió

- Transport i instal·lació de l'instrument en les nostres instal·lacions.

HA DE DIR:

Lot 3: Equip de soldadura de xip de boca a terra (Flip-Xip Bonder) d'almenys 5µm de precisió

- Transport i instal·lació de l'instrument en les nostres instal·lacions. L'equip ha de poder entrar per una porta de 1.2m de pas, per a la seva posterior posta en marxa.

Barcelona,

Joan Guàrdia Olmos
Rector de la Universitat de Barcelona
Òrgan de Contractació

Contra aquesta incoació els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs especial, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent a aquell en que s'hagi tramès la notificació de l'acte impugnat, en base a l'establert a l'art. 44 i següents de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. Interposat l'esmentat recurs, quedarà en suspens la tramitació de l'expedient de contractació fins a la resolució del mateix. Fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs especial no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.

Finançat per